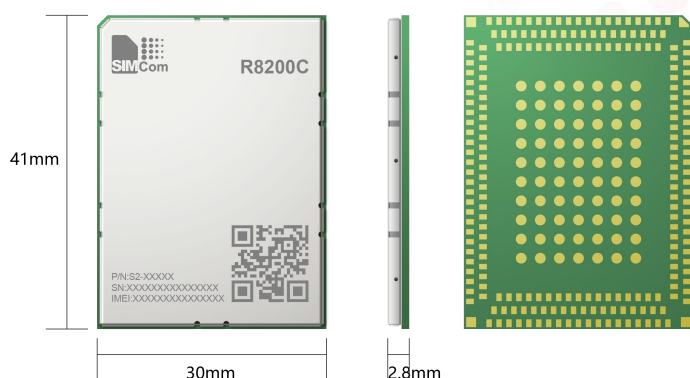


V: 2022.5

R8200C

SIMCom 5G Sub-6G 模块



产品介绍

R8200C是支持多频段5G NR / LTE-FDD / LTE-TDD / HSPA+模块，支持R15版本，支持NSA / SA组网。

具有强大的扩展能力，具有丰富的接口，包括SPI，PCIe2.0，USB3.0，GPIO等。该模块为客户的应用程序提供了很好的灵活性和易于集成的能力。

R8200C LGA小尺寸封装，在提供丰富接口的同时，减小占用面积，为客户终端ID设计提供更多的空间和自由度

专为在各种无线传播条件下，提供5G接入服务，为需要大吞吐量的数据通信应用而设计。由于高效，灵活，低成本独特属性，该模块非常适合许多应用。



产品优势

- ◆ 具有丰富接口
- ◆ 大吞吐量数据传输
- ◆ 国产芯片
- ◆ Release 15

Product R8200C	
封装方式	LGA
尺寸(mm)	30*41*2.8mm
支持频段	5G-NR N1,N3,N5*,N8,N28,N40,N41,N77,N78,N79
	LTE-FDD B1,B3,B5,B8,B28
	LTE-TDD B34,B38,B39,B40,B41
	WCDMA B1,B5,B8
定位	不支持
工作温度	-30°C~+75°C
扩展工作温度	-40°C ~ +85°C
电气属性	
工作电压(V)	3.3 ~ 4.4, 典型值3.7
耗流	TBD@ Power off TBD @ Sleep, 典型值 TBD @ idle USB active
数据传输	
Sub-6G SA	2Gbps(DL)/1Gbps(UL)
Sub-6G NSA	2.2Gbps(DL)/575Mbps(UL)
LTE	600Mbps(DL)/150Mbps(UL)
HSPA+	42Mbps (DL)/11Mbps(UL)
软件属性	
支持协议	TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SSL3.0/MQTT
TLS	•
文件系统	•
FOTA	•
Android RIL	Android 6/7/8/9/10
USB Driver	Microsoft Windows Win7/Win8/Win10/Linux/Android
MBIM	Win8/Win10
NDIS	Linux/Win7/Win8/Win10
固件升级	USB
接口	
SIM Card	1.8V/2.95V
USB	•
PCM	•
I2C	•
接收分集	•
认证	
Regulatory	CCC/SRRC/CTA

*: 正在进行中/规划中 **: 目前支持R15, 可以升级至R16